

Innovationspreis

Die produkt- und/oder projekt-orientierte Zusammenarbeit zwischen Architekten und Industrieunternehmen im Bereich Böden, Bodenbeläge und Bodensysteme ist eine Form des Zusammenwirkens mit höchstem Innovationspotenzial. Dabei liefern das gemeinsame Ziel und die unterschiedlichen Voraussetzungen der Produktentwickler eine sichere Grundlage für ein erfolgsversprechendes Ergebnis. Der von den Architekturfachzeitschriften AIT, ABIT und Intelligente Architektur ausgelobte Innovationspreis Architektur und Boden der AIT zeichnet diese Form der Zusammenarbeit aus.

Die Jury

Dipl.-Ing. Gesche Grabenhorst,
Ahrens Grabenhorst Architekten,
Hannover
Dipl.-Ing. Jutta Kehr,
Vizepräsidentin BDIA,
Erfurt
Dipl.-Ing. Christian Kleine,
Kleine und Assoziierte Architekten,
Hannover
Dipl.-Ing. Corinna Kretschmar,
JOI Design,
Hamburg
Dipl.-Ing. Heiner Sendelbach,
Schneider + Sendelbach Architekten,
Braunschweig

Urkunde

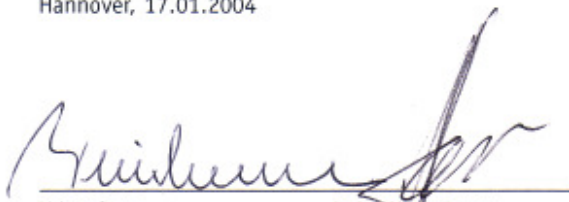
In der Kategorie
Produkte von hoher architektonischer Qualität

wird dem Unternehmen
Filzfabrik Fulda GmbH & Co.KG
für das Produkt
Fulda Chip
eine

Besondere Auszeichnung

verliehen.

Hannover, 17.01.2004



Dipl.-Kaufmann
Karl-Heinz Weinbrenner
Verleger Verlagsanstalt Alexander Koch

Dr.-Ing. Dietmar Danner
Redaktion AIT, ABIT
und IntelligenteArchitektur